

ガラスへの無粗化めっきプロセス

Etching-less plating process onto Glass

ドライプロセス不要でガラスの平滑性、透明性を維持

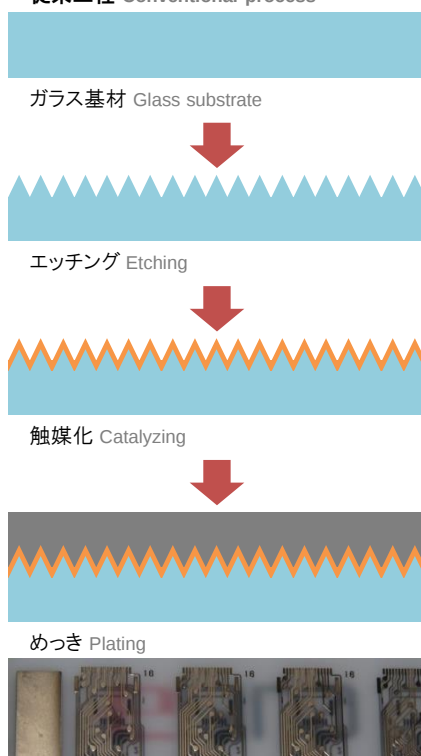
It is possible to maintain smoothness of the glass and the transparency without the dry process unnecessary

ガラスへのめっきプロセスでは、通常、フッ酸等の薬剤を用いて素材にエッチングを行い、めっき被膜との密着性を維持します。しかし、エッチングすることで透明度などのガラス特有の性質が失われてしまいます。また、めっきによる配線形成を行う場合、パターン間のリークが起きやすいといったデメリットもあります。弊社では、エッチングの代わりに密着層を形成することで、基材の平滑性を維持しながら密着の良いめっき被膜を成膜する技術を開発しました。

In the plating process onto the glass, etching with a chemical such as hydrofluoric acid is performed to maintain the adhesion of plating and glass. However, etching kills the specific properties of the glass, such as transparency. In addition, in the wiring formation by plating, there are also disadvantages such as leak between the patterns that occur frequently. Our company has developed a technique for forming an adhesion layer instead of etching. It is possible to form a plating film with good adhesion and smoothness of the glass substrate.

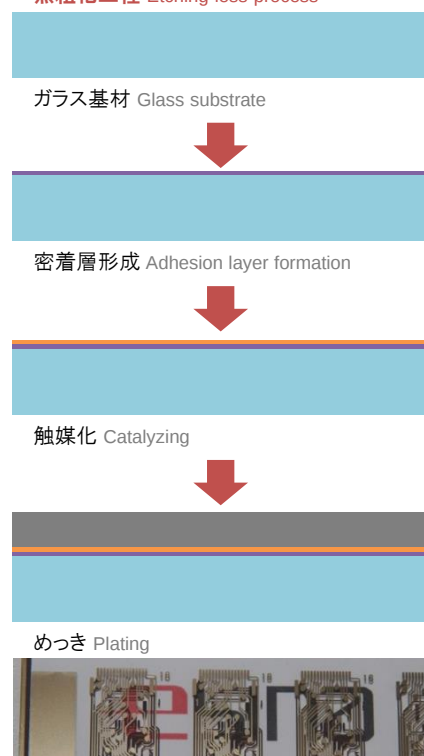
対応可能な主な素材 Supporting main material
石英ガラス Silica glass
ホウケイ酸ガラス Borosilicate glass
無アルカリガラス Alkali-free glass
ソーダ石灰ガラス Soda-lime glass
サファイアガラス Sapphire glass

従来工程 Conventional process



透明性が失われる
Transparency is lost

無粗化工程 Etching-less process



ebinaロゴがはっきり見える
Ebina logo clearly visible

■機能 Function

- 配線形成 Line formation
- 電極 Electrode

■用途 Application

- 配線基板 Wiring substrate
- TVのディスプレイ部品 Display parts for TV

エビナ電化工業株式会社 Ebina Denka Kogyo Co., Ltd.

〒144-0033 東京都大田区東糀谷5丁目22番13号 5-22-13 Higashikojiya, Ota-ku, Tokyo 144-0033, Japan

TEL 03-3742-0107 +81-3-3742-0107 FAX 03-3745-5476 +81-3-3745-5476

E-mail ebinax@ebinadk.com URL <http://www.ebinadk.com>

